

证券代码：603267

证券简称：鸿远电子

北京元六鸿远电子科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☒投资者开放日 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐一对一沟通
参会单位	华西银峰投资有限责任公司、青岛弘华私募基金管理有限公司、苏州高新私募基金管理有限公司、上海鼎赣投资发展有限公司、宁波电子信息集团、上海杉玺投资管理有限公司、上海般胜私募基金管理有限公司、北京汇信恒宝投资有限公司、重庆市博赛矿业(集团)有限公司、苏州苏高新产业投资有限公司、苏州明善投资管理有限公司、青岛国投投资控股有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、广州国聚创业投资有限公司、江西大成产业投资管理有限公司、上海君和资本、江苏苏豪投资集团有限公司、常州市金融投资集团有限公司、江西江投资本有限公司、湖南迪策投资有限公司、山东绿色发展私募基金管理有限公司、江苏高科技投资集团有限公司、上海固信投资控股有限公司、国海创新资本投资管理有限公司、广州开发区投资集团、四川发展未来智造私募基金管理有限公司、光大银行、上海同安投资管理有限公司等（排名不分先后）
时 间	2026 年 9 月 2 日
地 点	元六鸿远（苏州）电子科技有限公司（以下简称“鸿远苏州”）会议室
上市公司参会人员	副总经理、鸿远苏州总经理 盛海 董事会秘书 蒋南 财务总监 谢霞琴 证券事务代表 张成 投资者关系专员 王嘉宇

投资者关系活动 主要内容介绍	公司参会人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照相关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。
	一、公司概况 公司业务分为两大板块：自产业务和代理业务。自产业务聚焦于高可靠的瓷介电容器、滤波器、集成电路、微波模块、微纳系统集成陶瓷管壳等产品；代理业务，服务于多元化的民用市场。 2026 年上半年，公司实现营业收入 9.23 亿元，同比减少 9.32%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.19 亿元，同比增加 19.26%。 本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币 30,000 万元（含本数），且不超过公司最近一年末净资产的 20%，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
	（一）多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目投资总额约 1.42 亿元，其中拟使用募集资金约 1.24 亿元。本项目拟在现有生产基地内，通过改造部分厂房、购置先进生产与检测设备、升级软件系统，建设智能化产线，对微小型、高容量、高压安规瓷介电容器及可调电容器等产品进行产线技术升级改造和规模化量产。项目实施旨在系统性增强公司多层瓷介电容器产品的技术竞争力，推动产品向汽车电子、工业控制、服务器、高端医疗等民用高端领域拓展，优化公司整体业务结构。 （二）微纳系统封装管壳产业化项目投资总额约 1.56 亿元，其中拟使用募集资金约 1.41 亿元。为把握微纳系统封装市场快速增长及国产化的窗口机遇，巩固并提升公司在以 HTCC 技术为核心的微纳系统封装管壳产品技术与市场地位，公司将通过购置先进生产与检测设备、引进专业技术人才，在现有成熟工艺技术体系和业务模式的基础上，系统性地提升微波器件、光传感器、光模块等领域用微纳系统封装管壳的批量化生产能力与研

	发水平。本项目落地后，将有效扩大公司微纳系统封装管壳产品的供应规模，进一步完善公司电子陶瓷产品矩阵，深化关键技术布局，为公司奠定更加稳固的市场竞争地位。 （三）公司拟将募集资金中约 0.35 亿元用于补充流动资金，以满足公司日常运营资金需求，促进公司主营业务的持续健康发展，提升公司整体盈利能力。 二、互动环节 （一）2026 年上半年，高可靠领域产品的营业收入构成？自产业务民品的情况？ 2026 年上半年，公司营业收入 9.23 亿元，其中自产业务收入 4.90 亿元，具体构成：瓷介电容器 4.15 亿元、滤波器 0.15 亿元、集成电路 0.29 亿元、微波模块 0.20 亿元、陶瓷管壳 0.11 亿元。 在民用领域，民用瓷介电容器得益于 5G 通信设施规模化部署、半导体行业持续发展，以及医疗、仪器仪表、光通信等高端行业需求的拉动，收入规模实现同比增长。微纳系统集成陶瓷管壳在民用领域销售收入同比增长幅度较大，重点布局的光模块陶瓷管壳、大尺寸光传感器陶瓷管壳、3D 堆叠式商业卫星陶瓷管壳等实现批量供货。 （二）公司应收账款情况以及公司目前的回款情况？ 截至 2026 年 6 月末，公司应收账款约 16.10 亿元，较上年末有所增加，主要系 2025 年作为“十四五”收官之年，下游高可靠领域客户受政策驱动影响，采购需求集中释放，上年同期高可靠营业收入基数较高，相应形成的应收款项在本期内尚未完成回款。尽管应收账款金额较高，但客户以国央企集团为主，资质优良、坏账风险相对较低。同时，公司也将持续加强应收账款管理，密切跟踪重点客户回款进度，并严格按照会计准则足额计提
--	--

	坏账准备，以有效防范信用风险。 （三）两个募投项目的技术基础和客户储备情况如何，能否支撑项目顺利实施？ MLCC 项目方面，公司已建立从陶瓷介质材料开发、产品结构设计、制造工艺优化到成品可靠性验证的完整技术体系；已通过 IATF16949、ISO9001 等认证；在部分目标领域已完成产品送样、试供或小批量供货。 微纳系统封装管壳项目方面，公司已掌握 3D 堆叠高密度微波 SiP 陶瓷管壳、高导热光通信陶瓷管壳等核心技术；产品已通过严苛的合格供方认证，成功进入微波器件、光传感器、光模块等领域核心客户配套体系；光模块陶瓷管壳已实现小批量生产，大尺寸光传感器陶瓷管壳已完成客户送样，3D 堆叠式商业卫星陶瓷管壳已实现小批量交付。 （四）公司此次以简易程序募投的战略意图是什么？ 公司本次募集资金主要投向多层片式瓷介电容器及可调电容器产业化技术改造项目及微纳系统封装管壳产业化项目。本项目将依托公司在高可靠领域积累的共性技术平台，将材料、工艺及可靠性管控等方面的经验延伸至民用高端市场。本次定增将有力支持自产业务从高可靠为主转向“高可靠+民用高端”双轮驱动格局，推动产品向汽车电子、工业控制、服务器、高端医疗等领域渗透。 （五）多层瓷介电容器技改项目未来的行业趋势？ 尽管国内多层瓷介电容器企业在消费电子领域已实现规模化应用，但在高容量、高耐压等部分中高端规格产品上的自主供给能力仍存结构性不足，部分高端多层瓷介电容器仍依赖进口。其次，多层瓷介电容器及可调电容器的下游应用领域正经历快速技术迭代，对产品综合性能提出系统性挑战。在新能源汽车领
--	--

	域，整车高压平台向 800V 及以上升级，对安规多层瓷介电容器的耐压等级、高温稳定性及长期可靠性提出更高标准，车规级产品需通过 AEC-Q200 认证并在严苛工况下保持极低缺陷率。在服务器领域，高性能计算芯片功耗密度持续上升，要求更高容量、更小尺寸的多层瓷介电容器以实现低等效串联电感和快速瞬态响应，满足电源完整性需求。 （六）公司未来发展战略是否转为民品？ 高可靠领域是公司的战略基础，目前公司坚定看好民用高端领域，公司已审议通过未来五年发展战略规划纲要，推动产品向民用高端领域拓展，大力发展民品，对标行业头部企业，提高民品产能及规模，坚持高可靠与民用协同发展，两个板块优势互补，共同支撑公司长期稳健发展。
日 期	2026 年 9 月 2 日